

LITERATURVERZEICHNIS

In diesem Verzeichnis wird sowohl die von den Autoren dieses Leitfadens als auch andere in den letzten Jahren veröffentlichte relevante, teilweise auch über die **Thematik des Beschichten von elektronischen Baugruppen** hinausführende Literatur aufgeführt. Bei der aufgelisteten Literatur wird allerdings kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.

[Ala09]	R. Alarcon, „Umweltfreundliche Reinigung: Wasserbasierender Reinigungsprozess ersetzt HFCKM“, SMT, 22 (2009) Heft 08/09 S.14-15.
[Amb91]	S. Amberg-Schwab, E. Arpac, W. Glaubitt, K. Rose, G. Schottner und U. Schubert, <i>Materials Science Monographs – High Performance Ceramic Films and Coatings</i> , Vol. 67 (Ed: P. Vincencini), Elsevier, Amsterdam (1991), S. 203.
[Aßf04]	C. Aßfalg, „Reinigung und Bleifrei: Neuester Stand“, Productronic, Heft 5-6 (2004) 22-24.
[Asy06]	Seminar-CD zu Asymtek-Technology Days Juni 2006 mit Beiträgen von E. Vanlathem (Dow Corning), I. Sheiham (Beck), J. Mycke (Asymtek), M. Kaing (HumiSeal), S. Schröder (Peters), A. Hilton (Emerson & Cuming), I. Wilding, (Henkel), K.-F. Becker (IZM) und R. Tjburg (Philips).
[Bag88]	E. Bagda, „Zum Feuchtehaushalt von Beschichtungen“, farbe + lack 94 (1988) 8, 606-609.
[Ban07]	R.E. Banks, B.E. Smart, J.C. Tatlow, „Organofluorine Chemistry – Principals and Commercial Applications“, Springer-Verlag, New York, (2007).
[Bar94]	T.A. Barbari, R.M. Conforti, „Recent theories of gas sorption in polymers“ <i>Polymers for Advanced Technologies</i> , 5 (1994) 698-707.
[Bei06]	H. Beine, „Automatisch Dispensen a la Carte“, Productronic, Heft 1/2 (2006) S. 2-3.
[Bei10]	H. Beine, „Smart Coating – Beschichtung von elektronischen Baugruppen mit Fluorpolymer“, Productronic, Heft 11 (2010) S. 22-25.
[Bou10]	S. Boudier, „Mikroemulsion auf Wasser-Basis – Alternativen zu hohen Lösemittelbelastungen“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 01/02 (2010) S. 24-25.
[Bri08a]	J. Bridges, „Weg in die „grüne“ Zukunft – Eine neue Ära im Schutzlackbereich“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 03/04 (2008) S. 26-27.
[Bri08b]	J. Bridges, A. Stuart „Verlässlichkeit hoch, Kosten niedrig – Die Reinigung von Elektronik-Baugruppen ist unverzichtbar“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 07/08 (2008) S. 30-32.
[Bri11a]	J. Bridges, A. Stuart „Umweltschonend und flexibel – Entwicklungen und Trends in der Reinigungstechnologie“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 03/04 (2011) S. 32-33.
[Bri11b]	J. Bridges „Schutzlack oder Vergussmasse - Wahl der Methode der jeweiligen Anwendung entsprechend“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 05/06 (2011) S. 26-27.
[Bün04]	K. Bünning, „Aspekte zur Erhöhung der Temperaturwechselbeständigkeit von Leiterplatten“, PLUS, 10, (2004).
[Buc05]	J. Buch, „Flexibilität ist Trumpf – Schutzbeschichtung von elektronischen Baugruppen“, Teil 1: Productronic, Heft 04 (2005), Teil 2: Productronic, Heft 08/09 (2005), Teil 3: Productronic, Heft 10 (2005).
[Bus04]	I. Buschke, „Neue Erkenntnisse bei der Nutzung innovativer UV-aushärtender Lacke zum Schutz von Elektronik in der industriellen Produktion“, in: DVS/GMM (Hrsg.), GMM-Fachbericht, Band 44 „Elektronische Baugruppen“, Vorträge der DVS/GMM-Fachtagung 04./05. Februar 2004 in Fellbach; S. 295-301.
[CerXX]	Produktinformationen über <i>Certonal FC-732[®]</i> zum Schutz elektronischer Baugruppen; Quelle: Internetseiten der Fa. DAGE ELECTRONIC.
[Cha03]	T. Charlton, „Conformal Coatings Made Easy“, Circuits Assembly, Heft 10 (2003) 2-5.
[Con03]	„Facts & data book – Conformal Coating – Selection and Application“, Concoat Ltd., (2003).
[Dep00]	L. Depré, M. Ingram, Ch. Poinsignon und M. Popall, <i>Electrochim. Acta</i> 45 (2000) 1377.
[DowXX]	Produktinformationen über <i>Dow Corning[®]</i> Schutzlacke; Quelle: Internetseiten der Fa. Dow Corning Corporation.

[Dra07]	H.-G. Drape, „Parylene als Oberflächenschutz“, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 21. Juni 2007, Berlin, Tagungsband.
[DymXX]	Produktinformation „Schutzbeschichtungen für die Elektronikfertigung“ über Dymax® Schutzschichten; Quelle: Internetseiten der Fa. Dymax.
[Ehr99]	G.W. Ehrenstein, „Polymer-Werkstoffe“, Hanser-Verlag, (1999).
[Ein04]	„Einflussgrößen und Lösungswege aus der Sicht der Leiterplattenhersteller“, VdL, ZVEI – Panel Discussion, „Erhöhte Anforderungen an die Zyklenfähigkeit von elektronischen Baugruppen“, SMT 2004.
[Ell89]	B.N. Ellis, „Reinigen in der Elektronik“, Eugen G. Leuze Verlag, Bad Saulgau, (1989).
[Epp07]	„Emissionsfreie Produktion – Der Umweltgedanke zählt – selektives Beschichten von Baugruppen“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 09 (2007) S. 22.
[Epp08a]	„Flexibilität und Handling – Elektronik Dienstleister erweitert um Schutzlackierung (Selective Coating)“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 01/02 (2008) S. 26-27.
[Epp08b]	„Der Trend geht zur maschinellen Reinigung – Workshop zur Reinigung in der Elektronikfertigung“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 07/08 (2008) S. 6-8.
[Epp09a]	„Kundenanforderungen sind der Maßstab – Reparatur lohnt sich in der elektronischen Baugruppenfertigung“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 01/02 (2009) S. 26-27.
[Epp09b]	„Qualität und Zuverlässigkeit als Maßstab des Lohnreingers – Nicht nur Hochzuverlässigkeits-Baugruppen müssen gereinigt werden“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 05/06 (2009) S. 19.
[Epp10a]	„Reinigung optimiert Qualität und Kosten“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 01/02 (2010) S. 18-19.
[Epp10b]	„Prozess flexibel, Durchsatz hoch – Elektronikdienstleister erweitert seine Reinigungskapazitäten“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 09 (2010) S. 46-47.
[Epp10c]	„Grünes Coating – VOC-freie, flexible Schutzlacke mit ausgezeichneter Haftung“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 11 (2010) S. 21-23.
[Epp10d]	„Ruckzuck fixiert – Universeller Werkstückträger für den Lackier- und Trocknungsprozess“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 11 (2010) S. 30-31.
[Epp11a]	„Wie clean ist No-Clean wirklich? – Workshop zur Reinigung in der Elektronikfertigung“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 03/04 (2011) S. 34-37.
[Epp11b]	„Wirtschaftliche Beschichtung – Erfüllung der Kundenanforderungen als oberstes Ziel“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 03/04 (2011) S. 47-49.
[EriXX]	S. Erickson „Präzise Beschichtungstechniken für Conformal Coating Anwendungen“ unter www.gps-technologies.com bzw. „Precision coating deposition techniques for conformal coating applications“ unter www.ultraspray.com
[Eri04]	S. Erickson, „Prism ultra-coat conformal coating systems“ unter www.ultraspray.com
[Fla10]	T. Fladung, „Korrosionsschutz elektronischer Baugruppen durch Schutzlackierungen“, EBL 2010, 5. DVS/GMM-Tagung, 24./25. Februar 2010, Fellbach, Tagungsband S. 182-187. (DVS-Berichte Band 265; ISBN 978-3-87155-277-9)
[For08]	T.M. Forsythe, „Neue Methoden im Einzug – Bestimmung der Rückstandsfreiheit von Baugruppen mit geringen Boardabstand“, EPP, Heft 05/06 (2008) S. 62-65.
[Fre99]	J. Freund, J. Halbritter, J.K.H. Körber, „How dry are Dried Samples? Water Adsorption Measured by STM“, Microscopy Research and Technique 44 (1999) 327-338.
[Frö02]	L. Fröhlich, R. Houbertz, S. Jacob, M. Popall, R. Mueller-Fliedler, J. Graf, M. Munk und H. von Zychlinski, Mater. Res. Soc. Symp. Proc., 726 (2002) 349.
[Fun89]	W. Funke, E. Fischer, „Haftfestigkeit organischer Beschichtungen auf Metallen bei Einwirkung von Wasser“, Farbe + Lack 95 (1989) 6, S. 403-407.
[Gil07]	B. Gillespie, M. DeBenedetto, „Conformal Coating and Board Cleanliness“, Circuits Assembly, unter www.circuitsassembly.com am 01.02.2007.
[Hab97]	G. Habenicht, „Kleben“, Springer-Verlag, (1997).
[Haa00]	K.-H. Haas, Advanced Engineering Materials, 2 (2000) 571.
[Haa11]	J. Haase, E.-C. Reiff, „Optisch, berührungslos und leicht zu integrieren – Robuste Sensoren zur Profil- und Schichtdickenmessung“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 05/06 (2011) S. 51-53.

[Hoc02]	<i>“Hochtemperaturelektronik – Stand und Herausforderungen”</i> , VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik, Mikro- und Feinwerktechnik (GMM), (2002).
[Hou01]	R. Houbertz, J. Schulz und M. Popall, Mater. Res. Soc. Symp. Proc., 665 (2001) 321.
[Hou03]	R. Houbertz, G. Domann, J. Schulz und M. Popall, Mater. Res. Soc. Symp. Proc., 769 (2003) 239.
[Hou04]	R. Houbertz, Appl. Surf. Sci., 247 (2004) 504-512.
[GfK10]	Tagungsband GfKORR-Jahrestagung 2010 „Beschichtungssysteme zum Schutz elektronischer Baugruppen; 09./10. November 2010, Frankfurt./M, ISBN 978-3-935406-43-7
[Gho94]	K. Ghosal, B.D. Freeman, <i>„Gas Separation Using Polymer Membranes: An Overview“</i> , Polymers for Advanced Technologies, 5 (1994) 673-697.
[Gub04]	F. Gubbels, M. Onishi, <i>„Controlled volatility silicon conformal coatings: why and how to use them“</i> , Global SMT & Packaging, 10-14 (2004).
[Gub05]	F. Gubbels, M. Onishi, M. Stephan; <i>„Ausgasungen aus Siliconen“</i> , GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 09. Juni 2005, Berlin, Tagungsband.
[HdT07]	Tagungsunterlagen Fachveranstaltung <i>„Vergusstechnik für die Elektrotechnik und Elektronik“</i> , 22. März 2007; Haus der Technik, Essen.
[Jil03]	W. Jillek, G. Keller, <i>„Handbuch der Leiterplattentechnik“</i> , Band 4, Eugen G. Leuze Verlag, Bad Saulgau, (2003).
[Kai92]	W.-D. Kaiser, S. Pietsch, A. Rudolf, <i>„Zusammenhänge zwischen Permeations- und Adhäsionsverhalten sowie der Unterrostung organischer Beschichtungen“</i> , farbe + lack 98 (1992) 3, 182-187.
[KamXX]	M.R. Kamal, R. Saxon, <i>„Recent developments in the analysis and prediction of the weatherability of plastics“</i> , Applied Polymer Symposia, 4:1–2, 19678.
[Kin06]	P. Kinner, <i>„Maximieren Sie Ihr Investment: Prüfen Sie auf bleifrei und lösungsmittelfrei“</i> , SMT Heft 8-9 (2006) S. 14-16.
[Kin07]	P. Kinner, <i>„Schnell härtend und umweltverträglich – Schutzlack für anspruchsvolle Elektronik“</i> , Productronic, Heft 10 (2007) S. 42-44.
[KinXX]	P. Kinner, M. Kaing, J. Mycke, <i>„HumiSeal works with customer and equipment supplier to solve application issues during qualification of UV40 in the automotive industry“</i>
[Kli01]	W. Klingel, <i>„Die Zukunft der Schutzbeschichtung“</i> , Productronic, Heft 03 (2001).
[Kli03]	W. Klingel, <i>„Schutzbeschichtung als Dienstleistung“</i> , VTE, Heft 15 (2003) und Productronic, Heft 06 (2003).
[Kli04]	W. Klingel, <i>„Lackierpraxis heute“</i> , in: DVS/GMM (Hrsg.), GMM-Fachbericht, Band 44 „Elektronische Baugruppen“, Vorträge der DVS/GMM-Fachtagung 04./05. Februar 2004 in Fellbach; S. 313-316.
[Kli05a]	W. Klingel, <i>„Vergusstechniken für den Schutz von Flachbaugruppen“</i> , PLUS, Heft 5, (2005) 893-901.
[Kli05b]	W. Klingel, <i>„Fehlerbilder beim Schutzlackieren“</i> , GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 09. Juni 2005, Berlin, Tagungsband.
[Kli05c]	J.-H. Klingel, <i>„Nässe, Säure, Schmutz & Co. – Sichre Funktion durch Verguss“</i> , Productronic, Heft 5-6 (2005) S. 30-31.
[Kli05d]	J.-H. Klingel, <i>„Fehlerbilder beim Schutzlackieren – Vorbeugende Maßnahmen beim Lackieren“</i> , EPP, Heft 11-12 (2005) S. 59.
[Kli05e]	J.-H. Klingel, <i>„Im Sekundentakt – Selektive Schutzbeschichtung und Trocknung“</i> , Productronic, Heft 11 (2005) S. 81.
[Kli06a]	J.-H. Klingel, <i>„Klimaausfälle sind vermeidbar“</i> , Productronic, Heft 05 (2006) S. 64-65.
[Kli06b]	J.-H. Klingel, <i>„Verlaufsstörungen“</i> , Technische Information der Fa. Kunststoff-Chemische Produkte GmbH, Frielzheim, (2006).
[Kli06c]	J.-H. Klingel, <i>„Lackieren in Serie“</i> , automotion, Heft 12 (2006) S. 20-21
[Kli07a]	J.-H. Klingel, <i>„Klimaausfälle sind vermeidbar – Schutzlackierung als Dienstleistung“</i> , EPP, Heft 01/02 (2007) S. 34.
[Kli07b]	J.-H. Klingel, <i>„Schutzlackierung – Problemstellung und Lösungen aus der Praxis“</i> , Seminarunterlagen zum OTTI-Fachforum „Schutzmaßnahmen zur Klimasisicherheit elektronischer Baugruppen“, März 2007, Regensburg.

[Kli09a]	J.-H. Klingel, „Allroundtalent – Schutzbeschichtungsanlagen für elektronische Baugruppen“, Productronic, Heft 08/09 (2009) S. 23-25.
[Kli09b]	J.-H. Klingel, „Update für Lackieranlagen – Schutzbeschichtung bestückter Baugruppen“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 11 (2009) S. 47-49.
[Knö89]	P.A. Knödel, „Schutzlackierung von bestückten Leiterplatten“, Metalloberfläche, Heft 04-05 (1989).
[Knö03]	P.A. Knödel, „Partielle Beschichtung nichttauchfähiger Baugruppen“, Productronic, Heft 11 (2003).
[Knö04]	P.A. Knödel, „Schutzlackierung von Elektronik-Baugruppen bei großen Durchsätzen“, in: DVS/GMM (Hrsg.), GMM-Fachbericht, Band 44 „Elektronische Baugruppen“, Vorträge der DVS/GMM-Fachtagung 04./05. Februar 2004 in Fellbach; S. 309-312.
[Knö05]	P.A. Knödel, „Große Durchsätze ohne Probleme“, Productronic, Heft 11 (2005).
[Knö06]	P.A. Knödel, „Elektronikbaugruppen tauchlackieren mit Silikon-Schutzlack“, LPinfos, 40 (2006) 15-17.
[Knö11]	P.A. Knödel, „Reproduzierbar – Trocknung und Aushärtung von Schutzlacken“, Productronic, Heft 01/02 (2011) 32.
[Kol09]	P. Koller, „Baugruppenreinigung als Dienstleistung - Warum muss im Zeitalter von NoClean-Flussmitteln gereinigt werden?“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 07/08 (2009) S. 22-23.
[Kon09]	M. Konrad, „Vordefinierter Reinheitsgrad für Fluxentfernung in High-Yield-Anwendungen“, SMT, 22 (2009) Heft 08/09 S.12-13.
[Kuc11]	T. Kucharek, „Kostenfaktoren im Reinigungsprozess – Anschaffung und Betrieb von Reinigungsanlagen – Teil 1“, Productronic, Heft 03 (2011) 22-24.
[Län07]	M. Länzsch, „Wie gefährlich sind Flussmittelrückstände? – Normen, Vorschriften, Grundlagen“, Seminarunterlagen zum OTTI-Fachforum „Schutzmaßnahmen zur Klimasicherheit elektronischer Baugruppen“, März 2007, Regensburg.
[Lei07]	H. Leiner, „Die Schutzlackierung und Rückstände aus dem Lötprozess“, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 21. Juni 2007, Berlin, Tagungsband.
[Lem91]	J. Lemaire, R. Arnand, J.-L. Gardette, „Low temperature thermo-oxidation of thermoplastics in the solid state“, Polymer Degradation and Stability, 33 (1991) 277-294.
[Lic90]	J. C. Licari, L.A. Hughes, „Coating Materials For Electronic Applications“, Noyes Publications, Park Ridge NJ, (1990).
[Lie01]	J. Lienemann, „Testverfahren, Qualifikation und EMV“, IMTEK, Lehrstuhl für Simulation, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, (2001).
[Löw08]	R. Löw, J. Wilde, „Untersuchung zur Auswirkung von Feuchte auf elektrisch leitfähige Klebverbindungen“, GMM-Fachbericht Band 55 (ISBN 978-3-8007-3074-2) „Elektronische Baugruppen und Leiterplatten EBL 2008“, 4. DVS/GMM-Fachtagung, 13./14.02.2008, Fellbach, S. 213-218.
[Luc73]	W.A.P. Luck, „Structure of Water and Aqueous Solutions“, Verlag Chemie, Weinheim (1973).
[Mai08]	C. Maier, „Oberflächenschutzbeschichtung von elektronischen Baugruppen mit Parylene“, GMM-Fachbericht Band 55 (ISBN 978-3-8007-3074-2) „Elektronische Baugruppen und Leiterplatten EBL 2008“, 4. DVS/GMM-Fachtagung, 13./14.02.2008, Fellbach, S. 319-322.
[Man07]	O. Manger, H. Schweigart, „Wie sauber muss es sein? – Normen für die Reinigung von elektronischen Baugruppen“, Productronic, Heft 07 (2007) S. 18-21.
[Man11]	O. Manger, „Höchster Reinheitsgrad – Flexible Baugruppenreinigung für die Luft- und Raumfahrtindustrie“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 01/02 (2011) S. 25-26.
[Mar08]	B. March, A. Steinke, C. Matzner, C. Schimpf, „Ausfallverhalten elektronischer Baugruppen unter Betauungseinfluss“, GMM-Fachbericht Band 55 (ISBN 978-3-8007-3074-2) „Elektronische Baugruppen und Leiterplatten EBL 2008“, 4. DVS/GMM-Fachtagung, 13./14.02.2008, Fellbach, S. 201-206.
[Mark07]	C. Mark, „Teflondispersionen zum Schutz elektronischer Baugruppen“, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 21. Juni 2007, Berlin, Tagungsband.
[Mue07]	M. Müller, „Verarbeitung von Gießharzen auf Basis von Polyurethan - Verarbeitungsfehler und deren Vermeidung“, Seminarunterlagen der Fachveranstaltung „Vergusstechnik für die Elektrotechnik und Elektronik“ im Haus der Technik, Essen, 22. März 2007.

[Neh05]	F. Nehmeier, „ <i>Feuchtigkeit und Schutzlackierung in der Kfz-Elektronik</i> “, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 09. Juni 2005, Berlin, Tagungsband.
[Nev04]	B. Neves, „ <i>Accelerating PTH Reliability Testing while reducing Cost</i> “, EIPC-Summer Conference 2004, Basel.
[Nol68]	W. Noll, „ <i>Chemistry and Technology of Silicones</i> “, Academic Press (1968).
[Ott05a]; [Ott06a]; [Ott07a]; [Ott09a]; [Ott10a]; [Ott11a]	Tagungsband (CD) OTTI-Profiforum „ <i>Vergießen in der Elektrotechnik und Elektronik</i> “, 16./17. März 2005; 06./07. November 2006; 20./21. Juni 2007; 28./29. April 2009; 16./17. Juni 2010; 07./08. Juni 2011; OTTI-Kolleg.
[Ott06b]	Tagungsunterlagen (CD) OTTI-Fachforum „ <i>Produktion bleifreier elektronischer Baugruppen</i> “, 05./06. April 2006; OTTI-Kolleg.
[Ott07c]; [Ott08c]; [Ott09c]; [Ott10c]; [Ott11c]	Tagungsunterlagen (CD) OTTI-Fachforum „ <i>Schutzmaßnahmen zur Klimasicherheit elektronischer Baugruppen – Grundlagen, Technologien, Projektbeispiele</i> “, 14./15. März 2007; 02./03. April 2008; 01./02. April 2009; 24./25. März 2010; 30./31. März 2011; OTTI-Kolleg
[Pal08]	C. Palin, M. Kaing, J. Mycke, „ <i>Die richtige Dosis macht's – Schnell trocknender UV-Schutzlack</i> “, Productronic, Heft 05 (2008) S. 68-69.
[Pap06]	U. Pape, M. Rittner, T. Liebl, N. Neher, M. Nowotnick, „ <i>Untersuchung der Zuverlässigkeit hochtemperaturgeeigneter Baugruppen</i> “, GMM-DVS-Tagung, Fellbach, (2006).
[Pie92]	M. Piepho, „ <i>Sicherheitsaspekte bei der Gießharzverarbeitung</i> “, Elektrizitätswirtschaft, 91 (1992) 1760.
[Pie94]	M. Piepho, „ <i>Vergleich der Eigenschaften unterschiedlicher Kaltverguss-Systeme für elektrische Anwendungen (Energiebilanzen synthetischer und teilsynthetischer Vergussmassen)</i> “, Elektrizitätswirtschaft, 93 (1994) 1682.
[Pie95]	M. Piepho, „ <i>Vergleich von Vergussmassen</i> “, ETZ, 116, Heft 23-24 (1995) 22.
[Pie97]	M. Piepho, „ <i>Füllstoffe in Elektroisolierstoffen</i> “, ETZ, 118, Heft 6 (1997) 56.
[Pie01]	M. Piepho, „ <i>Unverzichtbar - Vergussmassen für Elektrotechnik und Elektronik</i> “, ETZ, Heft 16 (2001) 26-29.
[Pie03]	M. Piepho, „ <i>Unverzichtbar: Vergussmassen für Elektrotechnik und Elektronik</i> “, PU-Magazin, Heft 4 (2003).
[Pie06a]	M. Müller, O. Bartels, M. Piepho, „ <i>Verarbeitung von Gießharzen auf Basis von Polyurethanen</i> “, etz, Heft 7 (2006) 44-47.
[Pie06b]	M. Müller, O. Bartels, M. Piepho, „ <i>Verarbeitung von Gießharzen auf Basis von Polyurethanen</i> “, PU-Magazin, Heft Juni/Juli (2006) 125-130.
[Pie07a]	M. Piepho, „ <i>Vergussmassen, PUR, Epoxid, Silikon, Kohlenwasserstoffharze</i> “, Seminarunterlagen der Fachveranstaltung „ <i>Vergusstechnik für die Elektrotechnik und Elektronik</i> “ im Haus der Technik, Essen, 22. März 2007.
[Pol85]	<i>Polymer Permeability</i> , J. Comyn (ed.), Elsevier Applied Science, London (1985).
[Pol10]	G. Pollmann, „ <i>Klimaschock in der Steuerung kann fatale Auswirkungen haben – Schutz von Baugruppen beginnt bei der Reinigungstechnik</i> “, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 03/04 (2010) S. 24-25.
[Pop92]	M. Popall, J. Kappel, M. Pilz und J. Schulz, Mater. Res. Soc. Symp. Proc., 264 (1992) 353.
[Pop98]	M. Popall, M. Andrei, J. Kappel, J. Kron, K. Olma und B. Olsowski, Electrochim. Acta, 43 (1998) 1155.
[Pro10a]	„ <i>Rundum optimiert – Konturgenaue Schutzbeschichtung mit Lackvorhang</i> “, Productronic, Heft 04 (2010) S. 20.
[Pro10b]	„ <i>Lösemittel adé – Schutzlacke für die Elektronikfertigung</i> “, Productronic, Heft 05 (2010) S. 32-34.
[Plu82]	E.P. Plueddeman, „ <i>Silicone coupling agents</i> “, Plenum Press, New York, (1982).
[Plu10]	„ <i>Sauberkeit ist mehr als eine Zier – Reinigen in der Elektronikfertigung</i> “, PLUS, Heft 01 (2010) S. 113-118.
[Plu10c]	„ <i>Reinigungsstrategien für die Elektronikfertigung – Kostenoptimiert zu bedarfsgerechter Sauberkeit</i> “, PLUS, Heft 10 (2010) S. 2086.2089.

[Rie08]	J. Riess-Frohberg, A. Harein, „ <i>Neue Reinigungskonzepte helfen – Kostensparende Fehldruckreinigung</i> “, EPP, Heft 02/03 (2008) S. 34-35.
[Rin09]	K. Ring, „ <i>Prüfmethoden zur Beurteilung von Schutzmaßnahmen an elektronischen Baugruppen</i> “, PLUS, Mai (2009) S. 1122-1125.
[Rob98]	M.E. Robertsson, O.J. Hagel, G. Gustafsson, A. Dabek, M. Popall, L. Cergel, P. Wennekens, P. Kiely, M. Lebyy und T. Lindhal, Proc. 48 th Electron. Comp. Technol. Conf. (Seattle, Washington, USA), Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. 1998 IEEE Catalogue No. 98CH36206 (1998), S. 1413.
[Roc87]	E.G. Rochow, „ <i>Silicon and Silicones</i> “, Springer-Verlag, Heidelberg, (1987).
[Ros95]	K. Rose, in: <i>Organosilicon Chemistry II</i> , N. Auner, and J. Weis (eds.), VCH Weinheim, Germany (1995), p. 649.
[Ros11]	A. Rost, „ <i>Halogenfreie Lotpasten – ihr Einfluss auf die Baugruppenreinigung</i> “, SMT, 24 (2011), Heft 03, S. 22-26.
[Sche07]	W. Scheible, „ <i>Rechtliche Aspekte bei der Schutzbeschichtung elektronischer Baugruppen - Haftung</i> “, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 21. Juni 2007, Berlin, Tagungsband.
[SchlXX]	D. Schleiferböck, „ <i>Optimierung der Baugruppenlackierung</i> “, Firmenschrift Fa. Endress + Hauser GmbH & Co. KG.
[Schm96]	K.G. Schmitt-Thomas, S. Wege, H. Schweigart, „ <i>Klimabedingte Ausfälle elektronischer Baugruppen: Prüfbarkeit und Schutzstrategien</i> “, 25. Jahrestagung der Gesellschaft für Umweltsimulation e.V., Pfalz (1996) - Tagungsband, Karlsruhe: DWS Werbeagentur und Verlag, (1996), S. 14-1 bis 14-15.
[Schm97]	K.G. Schmitt-Thomas, S. Wege, H. Schweigart, „ <i>Wirksamkeit von Elektronik-Schutzlacksystemen gegen elektrochemische Migration und Kriechstrombrücken</i> “, in: Thomann (Hrsg.): Werkstoffe für die Informationstechnik. Frankfurt: DGM-Informationsgesellschaft, (1997) 151-155.
[Schm07]	W. Schmitt, „ <i>Eigenschaften von Lotrückständen und ihr Einfluss auf die Schutzlackierung</i> “, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 21. Juni 2007, Berlin, Tagungsband.
[Schu98]	G. Schulze, „ <i>Selektives Schutzlackieren von Baugruppen</i> “, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 09 (1998).
[Schu99]	G. Schulze, „ <i>Selektive und automatische Schutzbeschichtung von elektronischen Baugruppen</i> “, Productronic, Heft 07/08 (1999).
[Schu00]	G. Schulze, „ <i>Überragende Prozesskontrolle durch geschlossene Regelkreise</i> “, LP infos, Heft 11 (2000).
[Schu01a]	G. Schulze, „ <i>Berührungsloses Jet Dispensen in der Praxis</i> “, Productronic, Heft 03 (2001).
[Schu01b]	G. Schulze, „ <i>Automatische, selektive Beschichtung mit Dickschichtlacken</i> “, LP infos, Heft 04 (2001).
[Schu02a]	G. Schulze, „ <i>Automatische und selektive Schutzlackierung von bestückten Leiterplatten ohne zusätzliche Maskierarbeiten</i> “, GfKORR Tagung „Beschichtung elektronischer Baugruppen“ Februar 2002, Frankfurt/M., Tagungsband.
[Schu02b]	G. Schulze, M. Reighard, „ <i>Automatisch Schutzbeschichten</i> “, Teil 1: Productronic Heft 05 (2002) 28; Teil 2: Productronic Heft 06 (2002) 48; Teil 3: Productronic Heft 07/08 (2002) 24.
[Schu03]	G. Schulze, „ <i>Automatische und selektive Schutzlackierung von bestückten Leiterplatten ohne zusätzliche Maskierarbeiten</i> “, GfKORR Tagung „Beschichtung elektronischer Baugruppen“ März 2003, Berlin, Tagungsband.
[Schu04]	G. Schulze, „ <i>Aktuelle Technologien für die automatische und selektive Beschichtung von bestückten Flachbaugruppen</i> “, in: DVS/GMM (Hrsg.), GMM-Fachbericht, Band 44 „Elektronische Baugruppen“, Vorträge der DVS/GMM-Fachtagung 04./05. Februar 2004 in Fellbach; S. 303-308.
[Schu05a]	G. Schulze, „ <i>Prozessregelung bei automatisierten und selektiven Beschichtungsverfahren</i> “, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 09. Juni 2005, Berlin, Tagungsband.
[Schu05b]	G. Schulze, „ <i>Mehr Zuverlässigkeit durch Schutzlackierung</i> “, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 03/04 (2005).
[Schu05c]	G. Schulze, „ <i>Kontaktloses Dispensjet Verfahren</i> “, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 09 (2005).

[Schu05d]	G. Schulze, „ <i>Prozessregelung bei automatischen Beschichtungsverfahren</i> “, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 11 (2005).
[Schu06]	G. Schulze, „ <i>Beschichtung mit Prozessregelung</i> “, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 07/08 (2006).
[Schu07a]	G. Schulze, „ <i>Performance im Detail</i> “, Productronic, Heft 01-02 (2007) 21-22.
[Schu07b]	G. Schulze, „ <i>Automatische Dosierung und Beschichtung</i> “, Seminarunterlagen der Fachveranstaltung „ <i>Vergusstechnik für die Elektrotechnik und Elektronik</i> “ im Haus der Technik, Essen, 22. März 2007.
[Schu07d]	G. Schulze, „ <i>Innovative Dosiervverfahren mit integrierter Regelung</i> “, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 07/08 (2007) S. 36-38.
[Schu07e]	G. Schulze, „ <i>Emissionsfreie Produktion</i> “, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 09 (2007) S. 22.
[Schu07f]	G. Schulze, „ <i>Coating und Dispensing Plattform neu definiert</i> “, Productronic, Heft 12 (2007) S. 28-31.
[Schu07g]	G. Schulze, „ <i>Die Spectrum Plattform – Beschichtung und Dosierung in neuer Dimension</i> “, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 12 (2007) S. 30-31.
[Schu08a]	G. Schulze, „ <i>Pulsweitenmoduliertes Beschichtungsventil für die selektive Schutzbeschichtung und den Verguss von bestückten Flachbaugruppen</i> “, GMM-Fachbericht Band 55 (ISBN 978-3-8007-3074-2) „ <i>Elektronische Baugruppen und Leiterplatten EBL 2008</i> “, 4. DVS/GMM-Fachtagung, 13./14.02.2008, Fellbach, S. 329-334.
[Schu09a]	„ <i>Punktgenau und reproduzierbar – Selektive Schutzbeschichtung in neuer Dimension</i> “, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 01/02 (2009) S. 29-30.
[Schu09b]	„ <i>Innovative Lösungen im Dispensbereich</i> “, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 03/04 (2009) S. 62-63.
[Schu09c]	„ <i>Kleben und Beschichten in der Elektronikfertigung</i> “, Adhäsion, April (2009) S. 14-17.
[Schu09d]	„ <i>Neue Technologien für die selektive Schutzbeschichtung von bestückten Flachbaugruppen</i> “, PLUS, Mai (2009) S. 1131-1137.
[Schu10a]	G. Schulze, „ <i>Zuverlässiges Coating – Automatische optische Inspektion von Schutzbeschichtungen</i> “, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 03/04 (2010) S. 34-35.
[Schu10b]	G. Schulze, „ <i>High-quality module production – Dispensing and coating processes in the photovoltaic industry</i> “, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 09 (2010) S. 33-34.
[Schu10c]	G. Schulze, A. Rost, „ <i>Ressourceneffiziente Lackierung von Baugruppen</i> “, EBL 2010, 5. DVS/GMM-Tagung, 24./25. Februar 2010, Fellbach, Tagungsband S. 188-192. (DVS-Berichte Band 265; ISBN 978-3-87155-277-9)
[Schu11a]	G. Schulze, A. Rost, „ <i>Reinigung als Lösung – Lackierung: maximale Sicherheit bezahlbar gemacht</i> “, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 03/04 (2011) S. 54-56.
[Schw97a]	H. Schweigart, „ <i>Funktionssicherheit schutzlackierter elektronischer Baugruppen bei Feuchtklimabeanspruchung</i> “, München, Hieronymus-Verlag, 1. Auflage (1997), 2. Auflage (1998).
[Schw97b]	H. Schweigart, S. Wege, „ <i>Prüfung von Lötstoppmasken und Schutzlacken mittels thermischer Analyse</i> “ (SMT ES&S Hybrid, Nürnberg 1997) - Tagungsband, Berlin: VDE-Verlag, 1997, S. 175-183.
[Schw98]	H. Schweigart, „ <i>Einfluss der Umgebungsbedingungen auf die Schutzwirkung von Elektronikschutzlacken</i> “, 27. Jahrestagung der Gesellschaft für Umweltsimulation e.V., Pfinztal, (1998), Tagungsband.
[Schw99a]	H. Schweigart, „ <i>Ausfälle im Feld: teuer und vermeidbar?</i> “, Productronic, Heft 10 (1999).
[Schw99b]	H. Schweigart, „ <i>Die Schaden- und Schwachstellenanalyse als Instrument des Testtailoring für die Klimasicherheit elektronischer Baugruppen</i> “, 28. Jahrestagung der Gesellschaft für Umweltsimulation e.V., Pfinztal, (1999) Tagungsband.
[Schw00]	H. Schweigart, E. Christian, „ <i>Plus für hohe Zuverlässigkeit – Nachweis von Flussmittelrückstand und Aktivator auf Baugruppen</i> “, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 03 (2000).
[Schw01a]	H. Schweigart, „ <i>No clean und bleifrei: ein Widerspruch?</i> “, Productronic, Heft 10 (2001) 1-2.
[Schw01b]	H. Schweigart, „ <i>Fehlursachen klimatisch beanspruchter Elektronikschaltungen</i> “, SMT, Heft 04 (2001) 18-20.
[Schw03a]	H. Schweigart, S. Repp, „ <i>Oberflächenreinheit bei Bond- und Coating Prozessen</i> “, JOT, Heft 11 (2003) 36-38.

[Schw03b]	H. Schweigart, S. Strixner, A. Mühlbauer; „ <i>Optimal Reinigen unter BGAs?</i> “, Productronic, Heft 12 (2003).
[Schw03c]	S. Repp, H. Schweigart, „ <i>Zuverlässigkeit steigern – Reinigen in der Elektronikfertigung</i> “, Metalloberfläche, Heft 11 (2003) 35-38.
[Schw03d]	H. Schweigart, „ <i>Brauchen Coatings Reinigung?</i> “, VTE Verbindungstechnik in der Elektronik, 15, Heft 01 (2003) 20-24.
[Schw04]	H. Schweigart, „ <i>Reinheitsanforderungen und Reinigung vor der Beschichtung</i> “, in: DVS/GMM (Hrsg.), GMM-Fachbericht, Band 44 „Elektronische Baugruppen“, Vorträge der DVS/GMM-Fachtagung 04./05. Februar 2004 in Fellbach; S. 321-325.
[Schw05]	H. Schweigart, „ <i>Oberflächencharakterisierung vor der Beschichtung</i> “, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 09. Juni 2005, Berlin, Tagungsband.
[Schw06a]	H. Schweigart, S. Strixner, „ <i>Coatings schnell und kostengünstig prüfen – Testmethode zur Überprüfung von Schutzlackierungen elektronischer Baugruppen</i> “, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 5-6 (2006) 96-97.
[Schw06b]	H. Schweigart, „ <i>Wenn der Lack abgeht – Mindestreinheit der Oberfläche vor der Schutzbeschichtung</i> “, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 10 (2006) 30-32.
[Schw07a]	H. Schweigart, D. Borgend, „ <i>Bauelemente-Vorbehandlung durch Reinigung</i> “, Seminarunterlagen der Fachveranstaltung „Vergusstechnik für die Elektrotechnik und Elektronik“ im Haus der Technik, Essen, 22. März 2007.
[Schw08]	H. Schweigart, „ <i>Beschichtungsprobleme? – So hält ihr Lack!</i> “, SMT 21 Heft 5 (2008) 22-25.
[Schw09]	H. Schweigart, „ <i>Sichere Lackhaftung durch Reinigung vor dem Beschichten</i> “, PLUS, Mai (2009) S. 1126-1130.
[Sei07]	A. Seiwert, T. Lauer, „ <i>Der Vorteil eines modernen Reinigungsprozesses</i> “, SMT Germany, Heft 6-7 (2007) 19-20.
[Sei08]	A. Seiwert, „ <i>Reinigung von Flachbaugruppen als Vorbehandlung zum Klimaschutzüberzug</i> “, GMM-Fachbericht Band 55 (ISBN 978-3-8007-3074-2) „Elektronische Baugruppen und Leiterplatten EBL 2008“, 4. DVS/GMM-Fachtagung, 13./14.02.2008, Fellbach, S. 323-328.
[Sil89]	„ <i>Silicone: Chemie und Technologie</i> “, Vulkan-Verlag, Essen, (1989).
[Sil01]	„ <i>Übersicht über die Silicon-Chemie</i> “, Firmenschrift der Fa. Dow Corning Corp., (2001); veröffentlicht in erster Version von A. Colas unter dem Titel „ <i>La chimie des silicones</i> “ in Chimie Nouvelle, Vol. 8 (30) (1990) 847.
[Smt09]	„ <i>Reinigung – ein unverzichtbarer Prozessschritt</i> “, SMT, 23 (2010), Heft 05 S. 24-25
[Ste07]	M. Stephan, „ <i>Silicones for Automotive Electronics Applications: Advances in Adhesives and Thermal Materials</i> “, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 21. Juni 2007, Berlin, Tagungsband.
[Sti07]	M. Stieglmeier, „ <i>Wie finde ich meinen optimalen Reinigungsprozess – Handlungsempfehlungen für die Wahl des richtigen Reinigungsequipments</i> “, EPP, Heft 10 (2007) S. 36-39
[Str02]	U. Streppel, P. Dannberg, Ch. Wächter, A. Bräuer, L. Fröhlich, R. Houbertz und M. Popall, Opt. Mater., 21 (2002) 475.
[Str07]	S. Strixner, „ <i>In einem einzigen Prozess reinigen? – Bleifreie und bleihaltige Baugruppen</i> “, Productronic, Heft 3 (2007) 28-31
[Str10]	W. Strunz, H. Schweigart, „ <i>Impedanzspektroskopie als Werkzeug zur Qualitätssicherung von bestückten und unbestückten Leiterplatten</i> “, EBL 2010, 5. DVS/GMM-Tagung, 24./25. Februar 2010, Fellbach, Tagungsband S. 142-147. (DVS-Berichte Band 265; ISBN 978-3-87155-277-9)
[Sup00]	M. Suppa, „ <i>Der Einsatz von Vergussmassen in der Elektronik</i> “, Teil 1: PLUS, Heft 03 (2000), Teil 2: PLUS, Heft 06 (2000), Teil 3: PLUS, Heft 08 (2000).
[Sup01a]	M. Suppa, M. Kollasa „ <i>Dickschicht-Beschichtungsstoffe und schnelle Schutzlackierprozesse – ein Widerspruch?</i> “, PLUS, Heft 08 (2001) und Ref.-Nr. 152 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2001).
[Sup01b]	M. Suppa, „ <i>Dickschichtbeschichtungsstoffe und schnelle Schutzlackierprozesse – Dick aufgetragen, schnell getrocknet</i> “, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 04 (2001).
[Sup02]	M. Suppa, „ <i>Conformal coatings for Component Protection</i> “, Circuits Assembly, Vol. 13, Heft 06 (2002).
[Sup03]	M. Suppa, „ <i>Schutzlacke und Vergussmassen als Beschichtungsstoffe für elektronische Baugruppen</i> “, VTE Aufbau- und Verbindungstechnik, Heft 01 (2003).

[Sup04a]	M. Suppa, „Die Schutzlackierung von elektronischen Baugruppen – von High-Solid-Lacken über wasserverdünnbare hin zu lösemittelfreien Schutzlacken“, in: DVS/GMM (Hrsg.), GMM-Fachbericht, Band 44 „Elektronische Baugruppen“, Vorträge der DVS/GMM-Fachtagung 04./05. Februar 2004 in Fellbach; S. 287-294 bzw. als Ref.-Nr. 159 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2004).
[Sup04b]	M. Suppa, „Reinheit und Beschichtung elektronischer Baugruppen – Klima- und Kriechstromzuverlässigkeit“, Ref.-Nr. 160 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2004).
[Sup04c]	M. Suppa, „Ökologische Technologien und Beschichtungsstoffe für Leiterplatten“, Ref.-Nr. 155 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2004).
[Sup04c]	M. Suppa, „Zuverlässigkeitsprüfungen und Ausfallmechanismen bei Lötstopplacken“, VdL, ZVEI – Panel Discussion, „Erhöhte Anforderungen an die Zyklenfähigkeit von elektronischen Baugruppen“, SMT 2004.
[Sup04d]	M. Suppa, „Temperaturstress – Auswirkungen auf Schutzlacke in der Elektronik“, Metalloberfläche, Heft 11 (2004) 35-38.
[Sup04e]	M. Suppa, „Der komplette Lifecycle ist entscheidend – Beschichtungsmaterialien für Leiterplatten aus ökologischer Sicht“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 03 (2004).
[Sup05a]	R. Dietrich, P. Heuser, W. Peters, M. Suppa, „Schutzlacke und Vergussmassen als Beschichtungsstoffe für elektronische Baugruppen“, Ref.-Nr. 150 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2005).
[Sup05b]	M. Suppa, „Thermische Beständigkeit von Schutzlacken“, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 09. Juni 2005, Berlin, Tagungsband.
[Sup05c]	M. Suppa, „Silikone als Beschichtungsstoffe in der Elektronik“, PLUS, Heft 9, (2005) 1609-1615.
[Sup05d]	M. Suppa, „Temperaturstress und Temperaturwechseltests – Auswirkung auf Schutz- und Lötstopplacksysteme“, Ref.-Nr. 161 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2005).
[Sup06a]	M. Suppa, „RoHS, ELV und WEEE und ihre Auswirkungen auf die Beschichtungsstoffe für die elektronische Industrie“, Ref.-Nr. 162 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2006).
[Sup06b]	M. Suppa, „Silikone als Beschichtungsstoffe in der Elektronik“, Ref.-Nr. 163 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2006).
[Sup06c]	M. Suppa, „Zuverlässigkeit von fotostrukturierbaren Lötstopplacken für elektronische Baugruppen bei Belastung durch Temperaturdauerstress und Temperaturwechselstress“, DVS/DMM-Tagung, Fellbach, (2006) und PLUS, Heft 4, (2006) 659-666.
[Sup06d]	M. Suppa, „Temperaturresistente Schutzlacke“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Teil 1: Heft 1/2 (2006); Heft 4 (2006).
[Sup06e]	M. Suppa, „Schnellste Prozessierung von Schutzlacken mit der UV-Technologie“, PLUS, Heft 6, (2006) 870-876.
[Sup06f]	M. Suppa, „Beschichtungsstoffe für elektronische Baugruppen bei Belastung durch hohe Temperaturen und hohe Feuchte“, LPinfos, 40 (2006) 4-6.
[Sup06g]	M. Suppa, „The reliability of photoimageable solder resists“, Circuitree, (2006).
[Sup07a]	M. Suppa, „Schutzlacke zur Verbesserung der Klimasicherheit elektronischer Baugruppen“, Seminarunterlagen zum OTTI-Fachforum „Schutzmaßnahmen zur Klimasicherheit elektronischer Baugruppen“, März 2007, Regensburg.
[Sup07b]	M. Suppa, „Schutzlacke – Dickschicht-Beschichtungsstoffe und Applikationen – Teil 1“, Productronic, Heft 7 (2007) S. 23-24.
[Sup07c]	M. Suppa, „Schutzlacke – Dickschicht-Beschichtungsstoffe und Applikationen – Teil 2“, Productronic, Heft 8/9 (2007) S. 27-29.
[Sup07d]	M. Suppa, „Conformal coatings and their increasing importance for a safe operation of electronic assemblies“, Circuit World, 33, Heft. 4 (2007).
[Sup08a]	M. Suppa, „Prüf- und Teststrategie Schutzlacke und Lotpasten und Prozesse“, GMM-Fachbericht Band 55 (ISBN 978-3-8007-3074-2) „Elektronische Baugruppen und Leiterplatten EBL 2008“, 4. DVS/GMM-Fachtagung, 13./14.02.2008, Fellbach, S. 157-164.
[Sup08b]	M. Suppa, T. Touré, „Feuchteschutz und Wärmeableitung bei LEDs durch Microverguss mit dem Dickschichtlack TWIN-CURE®“, Productronic, Sonderheft „light & building“, (2008).

[Sup08c]	M. Suppa, „Die thermische Analyse in der Lack- und beschichtungsanalytik“, LPinfos, 44 (2008) 4-7
[Sup08d]	M. Suppa, „Deutlich erhöhte Schutzwirkung – Neues zu Dickschicht-Beschichtungsstoffen und ihren Applikationsprozessen“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 09 (2008) S. 75-77.
[Sup08e]	M. Suppa, „Schutzlackierung zur Verbesserung der Klimasicherheit elektronischer Baugruppen“, OTTI-Fachforum „Schutzmaßnahmen zur Klimasicherheit elektronischer Baugruppen“, 02.-03.04.2008 Regensburg, Tagungsband..
[Sup08f]	M. Suppa, „Feuchte bleibt draußen, Wärme wird abgeführt, LED-Schutz durch Mikroverguss“, productronic SPEZIAL Mai 2008.
[Sup09a]	M. Suppa, „Schutzbeschichtung für elektronische Baugruppen bei Belastung durch hohe Feuchte und Betauung“, PLUS, Heft 5 (2009) S. 1110-1121.
[Sup09b]	M. Suppa, „Beschichtungsstoffe für die Elektronikindustrie - WEEE, RoHS, ELV und EuP nehmen auf verschiedensten Ebenen Einfluss - Teil 1“, Elektronik, 7, (2009) S. 50-53.
[Sup09c]	M. Suppa, „Sicherer Schutz auch bei hoher Feuchtebelastung und Betauung – Schutzlacke für Elektronik-Baugruppen in Hochvoltanwendungen“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 09 (2009) S. 40-42.
[Supp09d]	M. Suppa, „Im Blick – Farbmeter zur Charakterisierung weißer Lötstopplacke“, Productronic, Heft 10 (2009) S. 55-57.
[Sup10a]	M. Suppa, H. Leiner, J. Tekath, „Schutzlacke, Lötstopplacke und Vergussmassen - optische Anforderungen und Leistungsfähigkeit bei LED Anwendungen“, EBL 2010, 5. DVS/GMM-Tagung, 24./25. Februar 2010, Fellbach, Tagungsband S. 111-119. (DVS-Berichte Band 265; ISBN 978-3-87155- 277-9)
[Sup10b]	M. Suppa, „Schutzlacke für elektronische Baugruppen“, Eigenverlag, 2010, ISBN 978-3-00-032764-3
[Tae08a]; [Tae09a]; [Tae10a]; [Tae11a]	Seminarunterlagen Technische Akademie Esslingen, „Vergießen und Verkapseln in der Elektrotechnik und Elektronik“, 13./14. März 2008, 15./16. September 2009, 12./13. Oktober 2010, 07./08. Juni 2011; Technische Akademie Esslingen, Ostfildern.
[Tae09b]; [Tae10b];	Seminarunterlagen Technische Akademie Esslingen, „Schutzbeschichtung (Lackierung) von elektronischen Baugruppen“, 29/30. Juni 2009, ??? 2010; Technische Akademie Esslingen, Ostfildern.
[Tau91]	C.J. Tautscher, „Contamination Effects on electronic products“ New York: M. Dekker, Inc., (1991).
[Teg98]	P.-E. Tegehall, „Impact of Contamination from Production Processes on the Reliability of Printed Board Assemblies“, Proc. Int. Conf. on Electronic Assembly: Materials and Process Challenges, pp. 69-80, (1998).
[Tut04]	Unterlagen zum Tutorial 25 „Reinheit und Beschichtung elektronischer Baugruppen – Klima und Kriechstromzuverlässigkeit“ – SMT HYBRID PACKAGING, Nürnberg, 15. bis 17.06.2004.
[Tut06]	Unterlagen zum Tutorial 24 „Die Schutzbeschichtung und ihre steigende Bedeutung für den sicheren Betrieb von elektrischen Baugruppen“ – SMT HYBRID PACKAGING, Nürnberg, 30.05. bis 01.06.2006.
[Uhl95]	S. Uhlig, L. Fröhlich, M. Chen, N. Arndt-Staufenbiel, G. Lang, H. Schröder, R. Houbertz, M. Popall und M. Robertsson, IEEE Trans. Adv. Packaging, Part B, 29 (2006) 158-170.
[Vin84]	C.R. Vincentz, „Glasurit-Handbuch Lacke und Farben“, Vincentz-Verlag Hannover, 11. Auflage, (1984).
[Wal01]	K.J. Wall, „Advanced development in silicone conformal coatings“, OnBoard Technology, June (2001).
[Weg00]	S. Wege, „Korrosionserscheinungen auf elektronischen Baugruppen unter Klimabeanspruchung“, Materials and Corrosion, 51, Heft 1 (2000) 7-12.
[Wol94]	H. Wolter, W. Storch und H. Ott, Mater. Res. Soc. Proc., 346 (1994) 143.
[Zas04]	H. Zastrow, K.-W. Lienert, G. Schmidt, „Lösemittelfreie Beschichtungen“, in: DVS/GMM (Hrsg.), GMM-Fachbericht, Band 44 „Elektronische Baugruppen“, Vorträge der DVS/GMM-Fachtagung 04./05. Februar 2004 in Fellbach; S. 317-320.
[Zas05]	H. Zastrow, „Lösemittelfreie Beschichtung“, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 09. Juni 2005, Berlin, Tagungsband.

[Zor98]	U. Zorll, „Lacke und Druckfarben“, Römpf-Lexikon, Georg Thieme Verlag (1998).
---------	---

Außerdem werden in folgenden Firmenschriften regelmäßig Artikel zur Thematik der Anwendung und Erzeugung von Schutzbeschichtungen für elektronische Baugruppen veröffentlicht:

- **Coating Newsletter**

(Kundeninformation der Fa. KC Produkte GmbH; www.kc-produkte.com; erscheint zwei- bis dreimal im Jahr)

- **LPinfos**

(Kundenzeitschrift der Fa. Lackwerke Peters GmbH + Co. KG; www.peters.de; erscheint zweimal pro Jahr)

- **ZESTRON news**

(Kundeninformation der Fa. Zestron Europe; www.zestron.com; erscheint dreimal pro Jahr)